



Add Goodness

地味だけど、すごい。素財のアデカ

くらしを豊かにする

Add Goodness

な“**素財**”を
提供

ライフサイエンス事業



食品事業



化学品事業

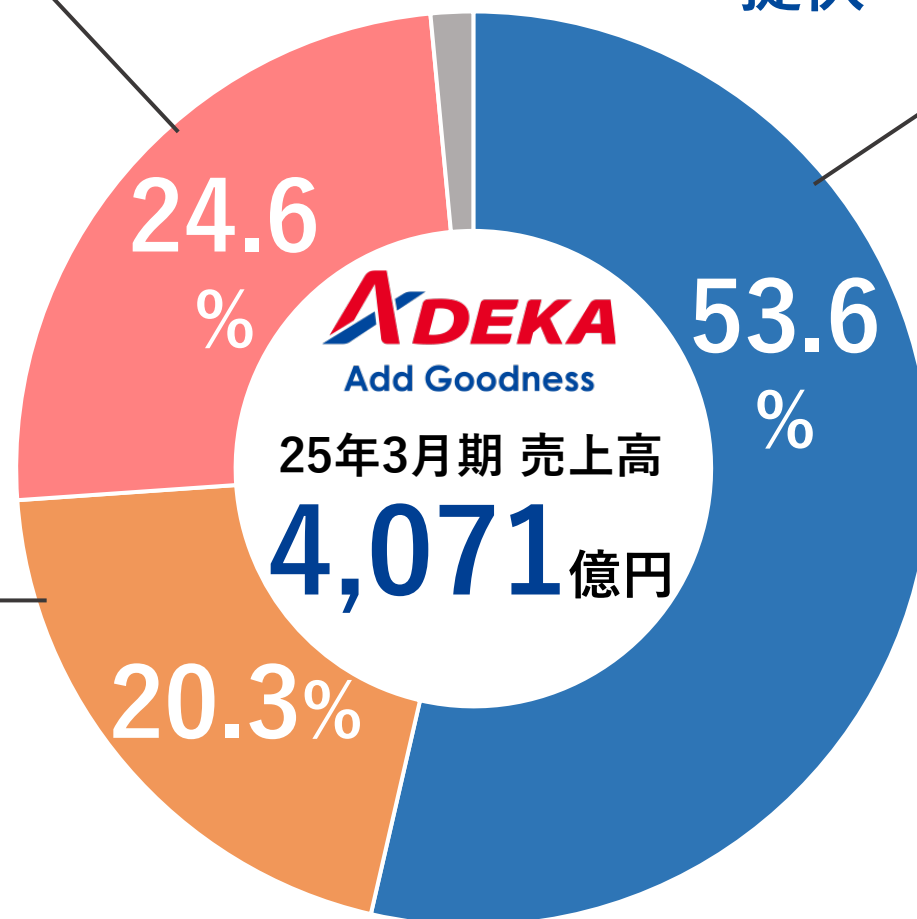
樹脂添加剤



半導体材料



環境材料



連結



【4 4 0 1】
日本基準

(億円)	25年 3 月期	(前期比)	26年 3 月期予想	(前期比)
売上高	4,071	+ 1.8%	4,410	+ 8.3%
営業利益	410	+ 15.8%	430	+ 4.9%
経常利益	393	+ 10.0%	430	+ 9.3%
純利益	250	+ 8.9%	264	+ 5.5%

2025年3月期：売上高、利益ともに過去最高を更新

2026年3月期：過去最高更新の見込み

ADX 2026

ADEKAグループ 中期経営計画 (FY2024-2026)

利益と効率性に重点を置き、“稼ぐ力”を高める3カ年

営業利益 (億円)

目 標

530億円

ROE (自己資本利益率)

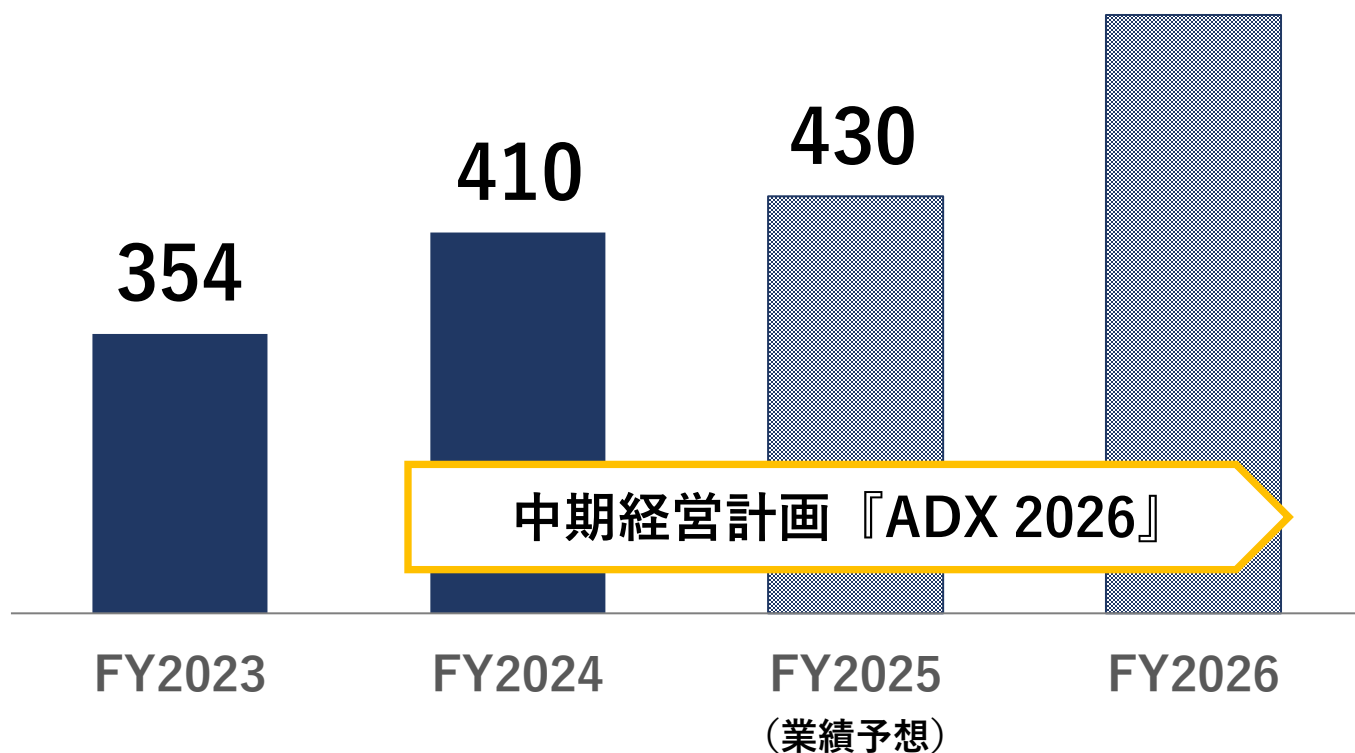
目 標

11.0%

ROIC (投下資本利益率)

目 標

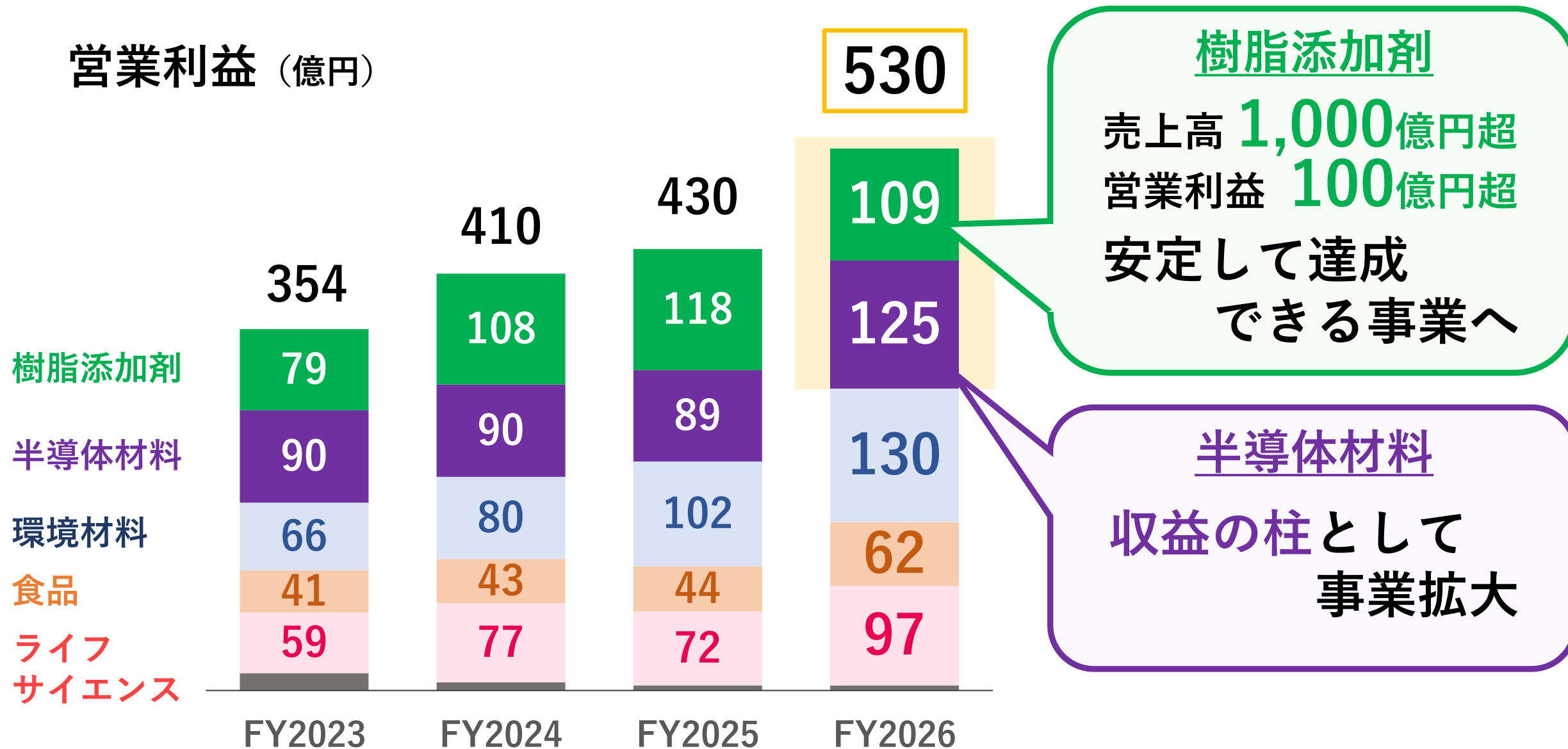
10.5%



ADX 2026

すべての事業で利益向上を目指す

営業利益（億円）



ADX 2026 樹脂添加剤

プラスチックに**世界最高***の透明性を付与

新規透明化剤「アデカトランスパレックス」

ガラスに見える？
でも、実はプラスチック！

TRANSPAREX™

アデカトランスパレックス™

圧倒的な透明性で、ポリプロピレンは新時代へ。

新規高性能透明化剤

2024年11月

米国・アジア圏を
皮切りに販売開始

2025年度

グローバル市場で
販売本格化

※ ポリプロピレンの透明性を厚さ1mm試験片で測定（Haze値）。当社試験によると市場におけるこれまでの最高性能はHaze値:3.2。
トランスパレックスを添加したポリプロピレンはHaze値:≦2.0を実証。Haze値は値が低いほど透明。（2024年11月1日時点、当社調べ）



ガラスに見える？でも、実はプラスチック！

TRANSPAREX™

新規高性能透明化剤 アデカトランスペレックス™

世界最高の透明性で、
ポリプロピレンの可能性を拡張

化粧品容器

透明性・耐薬品性



食品容器

透明性・耐熱性・
耐寒性



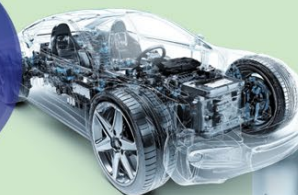
飲料ボトル

透明性・
アルコール対応



自動車部材

透明性・強度・
成形性



医療器具

透明性・耐薬品性



建 材

透明性・強度・
成形性



家 電

透明性・成形性



日用品雑貨

透明性・成形性

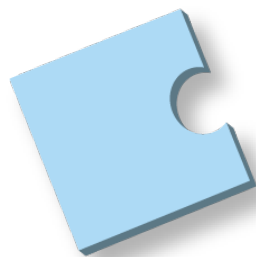
ペンキ (コーティング剤)

透明性・耐熱性・耐寒性

ポリスチレン
PET

(一般的な透明樹脂)

透明性



ポリプロピレン
+
トランスパレックス



両立



ポリプロピレン

耐熱性・耐薬品性
軽量化
環境



用途

化粧品容器, 食品容器,
自動車部材, 医療器具, 家電など

“透明”“高性能”“リサイクル容易（負荷低減）”なプラスチックを実現



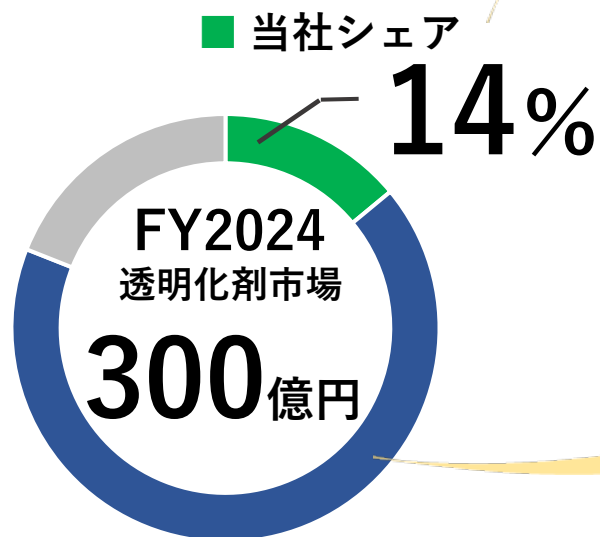
「トランスパレックス」でポリプロピレン市場の拡大を狙う！

2030年までに連結売上高 **300**億円、世界シェア**No.1**目指す

既存品を凌駕する、
圧倒的な透明性

ポリプロピレン向け透明化剤

✓ **シェア奪取**



■ 当社シェア

60%以上

“超高透明”な
ポリプロピレンの実現

透明樹脂からの代替を可能に

✓ **新規市場の獲得**

生成 A I の普及・拡大



半導体の進化

メモリ

HBM

ロジックIC

CPU

GPU

NPU

半導体材料

使用される
材料の種類・量

UP

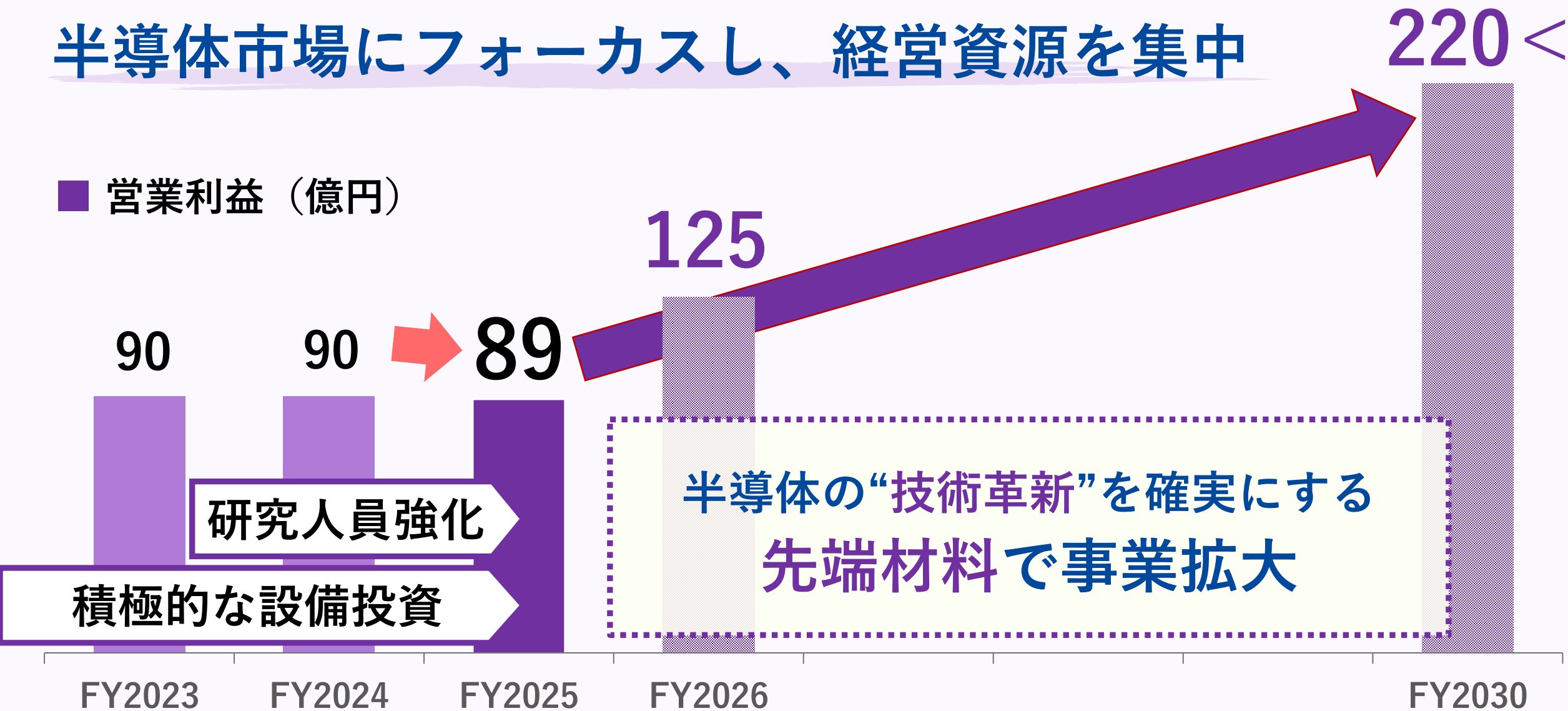
求められる
性能・品質

UP

ADX 2026 半導体材料

半導体市場にフォーカスし、経営資源を集中

■ 営業利益（億円）



注）金額は億円未満を切り捨てて表示

技術革新

半導体の微細化がさらに加速

A D E K A

2～3世代先に必要不可欠な
“先端材料”をスピーディに開発

先端メモリ

高誘電材料



設備投資
完了

先端ロジック

A L D材料



設備投資
完了

E U Vレジスト

半導体リソグラフィ材料



設備投資
完了

FY2025
下期以降

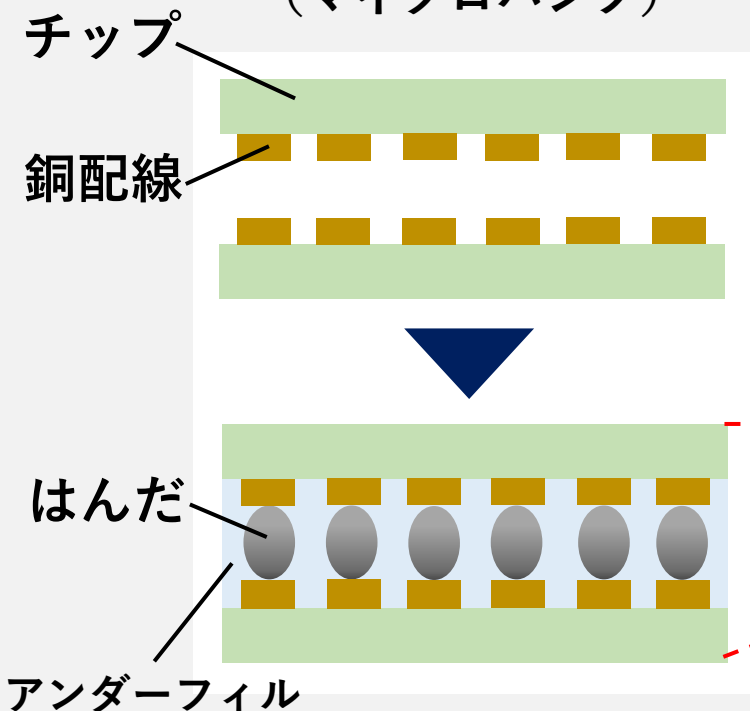
半導体の世代交代が進み、
“新製品”の出荷がスタートする見通し

注目分野

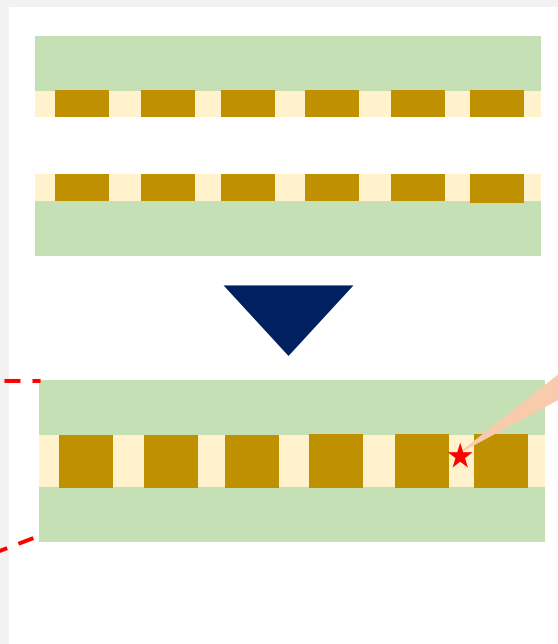
ハイブリッドボンディング

半導体パッケージの技術革新を担う新しい接合技術

現在～：2D～2.5D
(マイクロバンプ)



次世代：3D
(ハイブリッドボンディング)



銅配線同士をはんだで接続し
隙間をアンダーフィルで埋める

銅配線同士を直接接続できる

次世代材料(開発中)

- ・横浜国立大学と共同研究 (NEDO)
- ・当社の既存技術を応用

- ✓ 複雑化が進む後工程プロセスの負担を低減
- ✓ 従来より10分の1以上の省スペース化で高性能&省電力を実現

次世代メモリ/ロジックICの
高積層化/高集積化に貢献

株主・投資家の皆さまの期待に応えた経営

A D E K A の成長戦略

ADX 2026

稼ぐ力 サステナビリティ

強靱な経営基盤

+

東証の市場改革

資本効率と株価を
意識した経営



資本政策

さらなる
還元強化

業績向上・還元強化

～資本効率向上と株価水準向上を目指す～

取得価格の総額(上限)

180億円※

※ 自己資金

取得/消却株式の総数(上限)

1,000万株

発行済株式総数の

9.8%

(自己株式を除く)

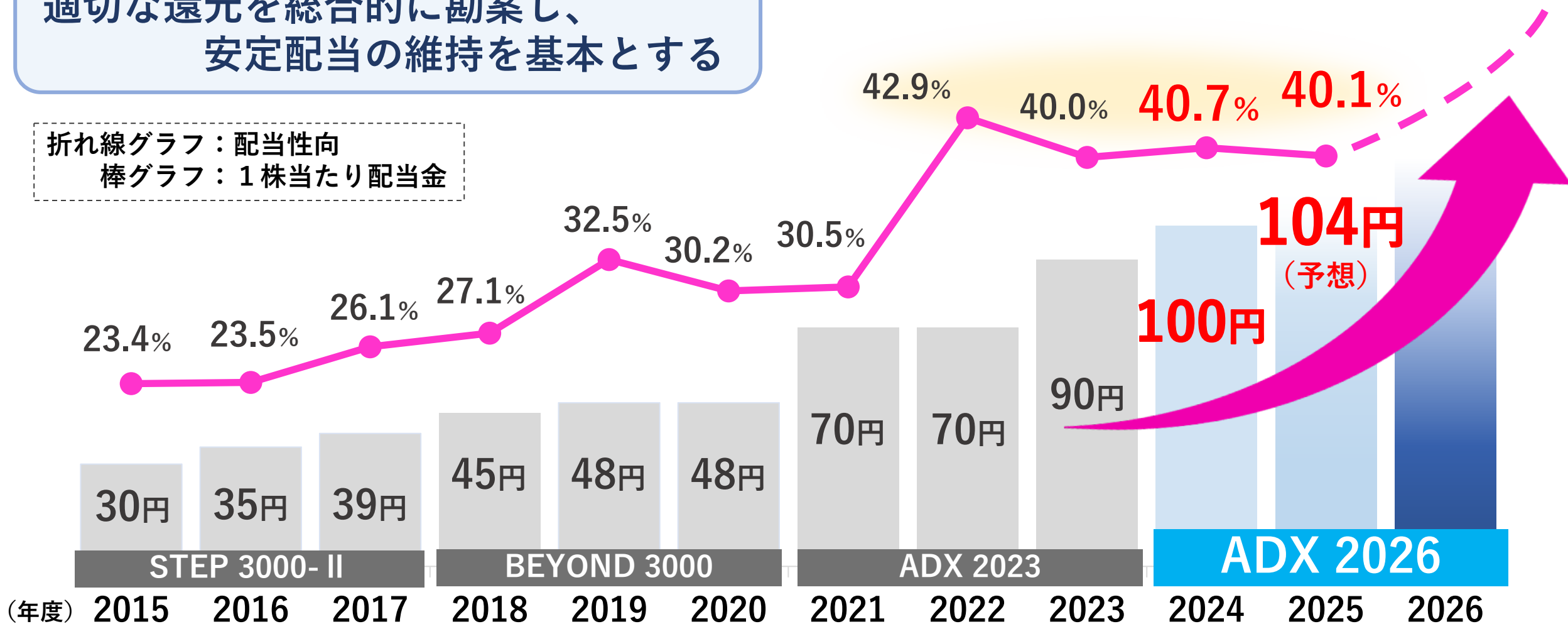
- 取得期間：2025年8月12日～2026年5月31日
- 消 却：2026年6月上旬（予定）

『ADX 2026』 配当方針

配当性向 **40%以上 維持**

適切な還元を総合的に勘案し、
安定配当の維持を基本とする

折れ線グラフ：配当性向
棒グラフ：1株当たり配当金



地味だけど、すごい。素財の



ADEKA
Add Goodness